

招待会社名 Invited by 招待会社名 Invited by

電子機器2023

トータルソリューション展

5.31 Wed. → 6.2 Fri. 10:00-17:00

東京ビッグサイト 東展示棟 2~6ホール+会議棟

完全WEB登録制 事前登録 パッと登録! パッと入場!

事前登録のうえ、来場者パスを出力しお持ちいただいた方は、当日会場内設置のパスホルダーをピックアップいただくだけでスムーズにご入場いただけます。

会場登録はこちらのWEBから www.jpcashow.com/ 招待状

入場料:1,000円(税込) WEB登録にて無料

www.jpcashow.com

来場のご案内


電子機器トータルソリューション展はWEB登録制となります。事前にWEBにて登録をお願い致します。本招待状のみでは入場できませんのでご注意ください。

STEP.1 公式ホームページより来場登録へお進みください。

STEP.2 ご登録いただいたメールアドレス宛に、パスワード設定のメールが届きます。24時間以内にパスワードの設定を完了してください。パスワード設定のメールが届かない場合は、事務局までお問合せください。

STEP.3 展示会当日、来場者マイページより「来場者証(来場者パス)」をプリントアウトし、四つ折りの状態で持参してください。パスポートをピックアップ頂き、来場者証を中に入れ、会場入り口にてバーコードをご提示ください。

公式HPはこちら



事前登録/最新情報はHPをご覧ください

開催概要

JPCA Show 2023 第52回東京電子機器展

JIEP マイクロエレクトロニクス 第37回最先端先端技術シンポジウム

JISSO PROTEC 2023 第24回最先端先端技術シンポジウム

5G/6G 第10回最先端先端技術シンポジウム

WIRE Japan Show 一般社団法人日本電子回路工業会

Electronics Component & Unit Show 一般社団法人日本電子回路工業会

E-Textile/Wearable 一般社団法人日本電子回路工業会

Smart Sensing 一般社団法人日本電子回路工業会

無人化/ロボティクス 一般社団法人日本電子回路工業会

Edge Computing 一般社団法人日本電子回路工業会

InterOpto 一般社団法人日本電子回路工業会

Imaging Japan 一般社団法人日本電子回路工業会

会期: 2023年5月31日(水)~6月2日(金) 10:00~17:00

会場: 東京ビッグサイト 東展示棟2~6ホール+会議棟

入場料: 1,000円(税込) ※招待券持参者及びWEB登録で無料

本部署務局: 一般社団法人日本電子回路工業会

運営事務局: 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

後援: 経済産業省(特選)

来場者参加型企画

ウェアラブル製品のデモ展示

今後さらなる市場拡大が見込まれる高付加価値のウェアラブルの技術を見て触れていただき、より身近に感じていただけます。

実装体験コーナー

工作キットを用い、簡単なハンダ付けを体験いただけます。半導体関連企業の新入社員や製造に携わる機会のない部署の社員の方、学生の方にもおすすめです。

主催者テーマ展示

「新しい基板の用途」や「基板製造プロセス」のテーマ展示を設けるとともに、基調講演やヒューマンコンピュータインターフェース、ウェアラブルデバイスなどの注目すべき講演と運動した特別展示を実施します。

セミナー会場G

電子機器トータルソリューション展 基調講演 (JPCA 創立60周年記念)

聴講料: 会員・VIP 無料、非会員 20,000円 / 1セッション (聴講料は税込です) ※JPCA会員/JIEP正会員、賛助会員、学生会員/JARA正会員、賛助法人会員/JEP、TEP会員

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|---|--|---|
| SDGs電子デバイス メタバースとSDGsで高成長を狙う! ~ニコン及び世界の半導体の大型プロジェクトに注目~ 泉谷 渉 株式会社ニコン 代表取締役社長 | 自動車 すべての人に移動の自由を -トヨタの自動運転技術開発の取組み- 藤澤 健 株式会社トヨタ自動車 代表取締役社長 | 半導体の未来 半導体、半導体製造装置 その未来と課題 寺本 章伸 株式会社ナノデバイス研究所 代表取締役社長 |
| 半導体/パッケージ 半導体・デジタル産業戦略の現状と今後 長野 洋平 経済産業省 高付加価値政策局 代表取締役 | ロボティクス/自動化 製造業が直面する労働力問題と電子業界への自動化の提案 ~製造現場に導入しやすい自動化を目指して~ 山口 賢治 株式会社ファナック 代表取締役社長 | 日本の半導体戦略 日本の半導体戦略 ~More Moore, More than Moore, More People~ 黒田 忠広 株式会社東京大学 大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センター 教授 |
| SIC/パワー半導体 脱炭素社会の実現に向け、ますます重要となるパワー半導体とアナログ技術 松本 功 株式会社ローム 代表取締役社長 | ウェアラブル/E-Textile ウェアラブルデバイスの切り拓く 人間とコンピュータの新たな関係 ~医療・健康・教育・エンタテインメント~ 寺田 努 株式会社コネクテックジャパン 代表取締役社長 | EV時代に対応する接合材料・実装技術 神谷 有弘 株式会社半導体基盤技術開発部 代表取締役社長 |

JISSO PROTEC 特別講演

優れた製品・技術内容や、新製品・新技術を促進させて展示会に活力を与え、総合的な技術の進歩発展を図っている出展者を表彰します。

表彰式日時: 会場についてはHPをご確認ください

半導体オプ・ザ・イヤーズ2023 受賞製品・技術発表

5月31日(水) 14:00~17:00 (受付開始13:30~)

於: セミナー会場G

JPCA 創立60周年記念特別講演 プログラム

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|--|--|--|
| 電子機器の歴史/展望 エレクトロニクス産業とイノベーションの波 片山 幹雄 東京大学 生産技術研究所 研究顧問 | 空飛ぶ自動車 空飛ぶクルマ時代のビジネスについて 浅井 尚 エアモビリティ 代表取締役社長&CEO | 半導体/実装技術 新たな世界的半導体イノベーション時代の幕開け 小池 淳義 Rapidus 代表取締役社長 |

JIEP 最先端実装技術シンポジウム

聴講するには事前登録のうえ、聴講料の支払いが必要ですが(VIP登録された場合も有ります)。会員区分によって聴講料が異なります。詳細・登録はHPよりご確認ください。 www.jpcashow.com/show2023/

※マークがついている講演資料は講演データ(有料)に含まれません

| Time | A会場 | | B会場 | |
|-------------|---|---|---|--|
| | 09:45-12:30 | 13:35-16:20 | 09:45-12:30 | 13:35-16:20 |
| 9:45-10:40 | 01A-1 ロボットが繊細な力覚作業を行う社会を支える 小型・軽力量センサ(仮題) ~MEMS+金属構造体のハイブリッド実装による商品化~ 井上 匡志 MHIセミコンダクター 技術専門職 | 01A-2 自動運転に向けたLiDAR技術の基礎と最新開発状況 高橋 昌幸 ソニーセミコンダクタソリューションズ 車載事業部 車載設計部 統括部長 | 01B-1 5G/6G に向けた高速・高周波用途向け基板材料の技術開発動向 廣川 祐樹 パナソニック インダストリー 電子材料事業部 電子基材BU 商品開発部 開発一課 課長 | 01B-2 5G/6Gを見据えた高周波対応材料の技術・開発動向 森野 正行 AGC 化学品カンパニー 企画部 材料開発室 室長 |
| 10:40-11:35 | 01A-3 住友精密工業のMEMS事業について 田中 洋 住友精密工業 技術開発部 MEMS事業部 事業室長 | 01A-4 自動運転システムとセンシングの最新動向 三宅 敏夫 青森 雅之 代表取締役社長 | 01B-3 低伝送損失低遅延を実現する低誘電率、高接合ポリイミド樹脂「PIAD」 田嶋 善司 旭川工業 研究開発部 FPC/フレキシブルデバイス開発部 グループリーダー | 01B-4 2023~24年の電子機器と半導体市場展望 南川 明 インフォマテック(株) コンサルティング シニアコンサルティングディレクター |
| 11:35-12:30 | 01A-5 自動運転システムとセンシングの最新動向 三宅 敏夫 青森 雅之 代表取締役社長 | 01A-6 ステレオカメラの認識技術とその応用 渡邊 龍人 ZMP ロボット開発部 チーフエンジニア | 01B-5 光電回路技術と半導体の役割 高木 直弘 谷元 昭 情報開発の救世主、真の省エネを具現化するパワー半導体! 土門 孝彰 渡邊 裕彦 代表取締役社長 | 01B-6 低炭素社会に貢献できる パワーデバイス・モジュール技術(仮) 多留 谷 政良 三菱電機 パワーデバイス製作所 主管技師長 |
| 13:35-14:30 | 01A-7 自動運転を支える光電融合実装技術(仮) 石井 雄三 日本電信電話 NTTデバイスイノベーションセンター プロジェクトマネージャー | 01A-8 2023~24年の電子機器と半導体市場展望 南川 明 インフォマテック(株) コンサルティング シニアコンサルティングディレクター | 01B-7 シリコンフォトニクスを用いた光電コネクティブパッケージ基板の研究開発 中村 文(国研) 産業技術総合研究所 プラットフォームフォトニクス研究センター 研究員 | 01B-8 次世代パワー半導体が貢献する「カーボンニュートラル」 梅本 清貴 ローム 顧客サポートプロジェクト 担当部長 |
| 14:30-15:25 | 01A-9 ステレオカメラの認識技術とその応用 渡邊 龍人 ZMP ロボット開発部 チーフエンジニア | 01A-10 自動車の電動化・パワーエレクトロニクスの動向と実装技術 三宅 敏夫 青森 雅之 代表取締役社長 | 01B-9 GaO/IV(ワ)デバイスと独自の「ワ」モジュールの社会実装を実現するグループ/IV-オン/IV-オン企業 竹内 健吾 FLOPSIA パワーデバイス事業本部 部長 | 01B-10 最先端半導体対応パッケージ基板技術 片桐 貴貴 新光電気工業 開発統括部 部長 |
| 15:25-16:20 | 01A-11 自動車の電動化・EV化の最新動向と関連技術(e-Axleや車載電池等)の今後の展望 加藤 克司 K&Kテクノロジーズ 代表 | 01A-12 自動車の電動化・EV化の最新動向と関連技術(e-Axleや車載電池等)の今後の展望 加藤 克司 K&Kテクノロジーズ 代表 | 01B-11 最先端半導体対応パッケージ基板技術 片桐 貴貴 新光電気工業 開発統括部 部長 | 01B-12 最先端パッケージ・サブストレートを支えるコア材料の最新動向 尾崎 昌久 東レテクノ エレクトロニクス事業部 パッケージソリューションセンター センター長 |
| 9:45-10:15 | 02A-1 先端実装の装置技術 奥田 博和 東レテクノエレクトロニクス 開発統括部 第一事業部 営業部 部長 | 02A-2 マイクロエレクトロニクス実装技術 最新技術動向 大岡 裕樹 テクニカルシステムズ コネクティブソリューション事業部 商品開発部 統括課長 | 02B-1 日の丸半導体復活、実現の鍵は...? Rapidus/LSTC, IBM, i-Mecが挑むシナリオ 西田 秀行 和嶋 元世 代表取締役社長 | 02B-2 LSTCの最先端半導体3Dパッケージングへの挑戦 菅沼 克明 大阪大学 フレキシブル3D実装協働研究所 所長・特任教授 |
| 10:40-11:35 | 02A-3 半導体設備のAR/VR, AIの採用動向 橋本 敬哉 東京エレクトロ(株) Corporate Innovation本部 副本部長 | 02A-4 100 Tb/s超スループットの実現に向けた光回路実装形態の予測と課題(仮) 竹嶋 元人 株式会社山崎 経営管理本部 IOWN推進部 部長 | 02B-3 最先端半導体対応パッケージ基板技術 片桐 貴貴 新光電気工業 開発統括部 部長 | 02B-4 レゾナンスの次世代半導体パッケージングに向けた取り組みとJOINT2進捗(仮) 山本 浩一 東レテクノ エレクトロニクス事業部 パッケージソリューションセンター センター長 |
| 11:35-12:30 | 02A-5 自動車の電動化・EV化の最新動向と関連技術(e-Axleや車載電池等)の今後の展望 加藤 克司 K&Kテクノロジーズ 代表 | 02A-6 自動車の電動化・EV化の最新動向と関連技術(e-Axleや車載電池等)の今後の展望 加藤 克司 K&Kテクノロジーズ 代表 | 02B-5 AR/VR/AIを牽引する半導体デバイス高集積度Interconnection技術(仮) 山本 浩一 東レテクノ エレクトロニクス事業部 パッケージソリューションセンター センター長 | 02B-6 パネルレベルファンアウト「FOLP」ならびにチップレット集積化 Die-to-Die Pillar-Suspended Bridge (PSB) 技術について 河野 一郎 アイ電子 開発部 FOLP/AA課 課長 |
| 13:35-14:30 | 02A-7 自動車の電動化・EV化の最新動向と関連技術(e-Axleや車載電池等)の今後の展望 加藤 克司 K&Kテクノロジーズ 代表 | 02A-8 自動車の電動化・EV化の最新動向と関連技術(e-Axleや車載電池等)の今後の展望 加藤 克司 K&Kテクノロジーズ 代表 | 02B-7 最先端半導体対応パッケージ基板技術 片桐 貴貴 新光電気工業 開発統括部 部長 | 02B-8 最先端パッケージ・サブストレートを支えるコア材料の最新動向 尾崎 昌久 東レテクノ エレクトロニクス事業部 パッケージソリューションセンター センター長 |
| 14:30-15:25 | 02A-9 自動車の電動化・EV化の最新動向と関連技術(e-Axleや車載電池等)の今後の展望 加藤 克司 K&Kテクノロジーズ 代表 | 02A-10 自動車の電動化・EV化の最新動向と関連技術(e-Axleや車載電池等)の今後の展望 加藤 克司 K&Kテクノロジーズ 代表 | 02B-9 最先端半導体対応パッケージ基板技術 片桐 貴貴 新光電気工業 開発統括部 部長 | 02B-10 最先端パッケージ・サブストレートを支えるコア材料の最新動向 尾崎 昌久 東レテクノ エレクトロニクス事業部 パッケージソリューションセンター センター長 |
| 15:25-16:20 | 02A-11 自動車の電動化・EV化の最新動向と関連技術(e-Axleや車載電池等)の今後の展望 加藤 克司 K&Kテクノロジーズ 代表 | 02A-12 自動車の電動化・EV化の最新動向と関連技術(e-Axleや車載電池等)の今後の展望 加藤 克司 K&Kテクノロジーズ 代表 | 02B-11 最先端半導体対応パッケージ基板技術 片桐 貴貴 新光電気工業 開発統括部 部長 | 02B-12 最先端パッケージ・サブストレートを支えるコア材料の最新動向 尾崎 昌久 東レテクノ エレクトロニクス事業部 パッケージソリューションセンター センター長 |

Electronics Component & Unit Show 特別講演

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|---|---|---|
| 眼鏡フレーム技術を活かしたARグラスの産官学共同開発事例の紹介 福井県工業技術センター 機械・金属部 デジタル技術研究 G 主任研究員 | 光導波路型合波器を用いたレーザー走査型映像投影装置の超小型化 福井大学 産学官連携本部 | エレクトロニクスの用途拡大 ~スポーツ分野への応用~(仮) 中尾 基 特命助教 |

PROTEC セミナー

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|---|--|--|
| 11:45-12:30 SDGsやカーボンニュートラルにフィットした後工程プロセスの省人化に貢献するデイスパンス技術の紹介 新井 武 武蔵エンジニアリング マーケティング戦略部 マーケティング戦略部 係長 | 12:55-13:40 実務で役立つフリーームはんだ印刷技術2023 若林 利昌 ヤマハ発動機 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT国内営業部 SPグループ | 14:05-14:50 FUJI Smart Factory 2.0の現在地 岩崎 正隆 FUJI ロボットソリューション事業部 ASP PJT プロジェクトリーダー |

JPCA プリント配線板技術ロードマップセミナー

5月31日(水) 13:00-14:00 2023年度版プリント配線板技術ロードマップ総論
宇都宮 久雄 インターコネクション・テクノロジーズ 代表取締役社長

6月1日(木) 13:00-14:00 高周波通信システム
西尾 健彦 株式会社SBRテクノロジーズ 代表取締役社長

6月2日(金) 13:00-14:00 多層プリント配線板ロードマップ
戸田 光昭 株式会社メコ 代表取締役社長

[JEITA] 半導体パッケージングセミナー

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|--|---|---|
| 14:00-16:00 E-Textile/Appliation(仮)に向けたワイヤ座敷会進捗報告セミナー 才田 義樹 奈良女子大学 生活工学共同専攻 教授・学長補佐 他(予定) | 14:00-16:00 高周波通信システム 西尾 健彦 株式会社SBRテクノロジーズ 代表取締役社長 | 14:00-16:00 多層プリント配線板ロードマップ 戸田 光昭 株式会社メコ 代表取締役社長 |

ダントツものづくりセミナー

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|--|--|---|
| 13:00-13:45 リーンなもののづくりセッション 特別講演1) 飛躍的な生産性を実現する 全体最適の働き方イノベーション 岸原 裕司 ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン CEO | 13:00-13:45 危機対応のつくり / 6Sigmaの経営 / DXセッション 特別講演2) 危機対応で進化する グローバルサプライチェーンとのつくり 新宅 健二郎 東京大学大学院経済学研究科教授 経済学博士 | 13:00-13:45 ROA / 管理会計セッション 特別講演4) トヨタ現場管理 田中 正和 トヨタ自動車 OB ものつくり大学名誉教授 / J-ネット研究所代表 |
| 13:45-14:30 特別講演2) 月曜日から金曜日まで全社一貫して 全体最適のマネジメント理論 TOCとは?~ 岸原 裕司 ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン CEO | 14:05-15:05 品質経営の取り組み方(シックスシグマ品質) アリス XIN LIU マイクロエレクトロニクス シニアマネージャー 工学博士 | 13:45-14:30 特別講演5) 現場改善のJ-ネット理論による強化策(ROA) 田中 正和 トヨタ自動車 OB ものつくり大学名誉教授 / J-ネット研究所代表 |
| 14:35-15:35 コロナ2019年のヨコハマ改革事例 一標準のないところにカイゼンはない 濱松 史郎 ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン CEO | 15:10-16:10 製造業DXを実現 GD.findi ~未来を予測し、最適解を導く、唯一のDX技術~ 大橋 輝彦 株式会社トヨタ自動車 OB カイゼンコンサルタントサービス 代表 | 14:35-15:35 特別講演6) 経営者に見える現場改善効果 [現場改善会計(GKC)] 特 繁 乃 愛知工業大学経営学部経営学教授 博士 (経営情報科学) |
| 15:40-16:25 JPCAものづくり大賞準大賞受賞 改善取り組み事例報告3件 2018年度 株式会社工機製作所CO加工事業部 2019年度 株式会社板橋機研工場 2021年度 FICT株式会社 | 16:15-17:00 JPCAものづくり大賞準大賞受賞 改善取り組み事例報告3件 2020年度 アスコテクノロジーズ新築工場 2021年度 株式会社メコ-福島工場 2021年度 太陽インキ製造株式会社九州事業所/埼玉工場 | 15:40-16:25 [総括基調講演] 経営効果がわかる、トヨタ生産システム 山本 治彦 JPCAものづくりアカデミー 校長 |

経済安全保障セミナー

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|--|---|---|
| 13:00-14:00 経済安全保障の確保に向けて -技術・データ・製品等の流出防止-(仮) 安田 謙一 経済安全保障特別調査室長 | 13:00-14:00 JPCA 熱関連セミナー 鈴木 康一 山口大学工学部 名誉教授 / 島山 友行 富山県立大学 准教授 | 13:00-14:00 高周波通信システム 西尾 健彦 株式会社SBRテクノロジーズ 代表取締役社長 |

熱関連セミナー

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 高周波通信システム 西尾 健彦 株式会社SBRテクノロジーズ 代表取締役社長 | 13:00-14:00 JPCA 熱関連セミナー 鈴木 康一 山口大学工学部 名誉教授 / 島山 友行 富山県立大学 准教授 | 13:00-14:00 高周波通信システム 西尾 健彦 株式会社SBRテクノロジーズ 代表取締役社長 |

高信頼性車載用電子回路評価基準ガイドラインセミナー

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|---|---|---|
| 10:30-11:15 高信頼性車載用電子回路評価基準ガイドラインセミナー 浦西 泰弘 JPCA高信頼性車載用電子回路評価基準WG 幹事 | 13:00-14:00 JPCA 熱関連セミナー 鈴木 康一 山口大学工学部 名誉教授 / 島山 友行 富山県立大学 准教授 | 13:00-14:00 高周波通信システム 西尾 健彦 株式会社SBRテクノロジーズ 代表取締役社長 |

Electronics Component & Unit Show 出展者セミナー

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|---|---|---|
| 13:00-14:00 高周波通信システム 西尾 健彦 株式会社SBRテクノロジーズ 代表取締役社長 | 13:00-14:00 JPCA 熱関連セミナー 鈴木 康一 山口大学工学部 名誉教授 / 島山 友行 富山県立大学 准教授 | 13:00-14:00 高周波通信システム 西尾 健彦 株式会社SBRテクノロジーズ 代表取締役社長 |

JIEP アカデミックプラザ

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|--|--|--|
| 13:00-13:20 深層学習を用いた動体認識システムにおける使用率の検討 長野工業高等専門学校 | 13:00-13:20 非感測浴からの第4級アンモニウム塩を用いた亜鉛-酸化チタン複合膜の作製 岡山県立大学大学院 | 13:00-13:20 聴覚障害者のための深層学習を用いた警告音可視化システムの開発 長野工業高等専門学校 |

製品安全セミナー

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|--|---|--|
| 13:00-14:00 製品安全の基礎「ぶりとばんじゅくV」をもとに解説 榎本 正男 株式会社パオパオ 代表取締役 | 13:00-14:00 高周波通信システム 西尾 健彦 株式会社SBRテクノロジーズ 代表取締役社長 | 13:00-14:00 聴覚障害者のための深層学習を用いた警告音可視化システムの開発 長野工業高等専門学校 |

製品安全セミナー

| 5月31日(水) | 6月1日(木) | 6月2日(金) |
|--|---|--|
| 13:00-14:00 製品安全の基礎「ぶりとばんじゅくV」をもとに解説 榎本 正男 株式会社パオパオ 代表取締役 | 13:00-14:00 高周波通信システム 西尾 健彦 株式会社SBRテクノロジーズ 代表取締役社長 | 13:00-14:00 聴覚障害者のための深層学習を用いた警告音可視化システムの開発 長野工業高等専門学校 |

*プログラムは都合により変更になる場合があります。予めご了承ください。

| 展示ホール | セミナー会場 G | NPIセミナー会場① | 展示ホール | セミナー会場 M | NPIセミナー会場② |
|-------------|--|------------|---|----------|-------------------|
| 10:55-11:15 | 小型電子部品の筐体接着、防水・防塵シーリング処理、潤滑剤塗布を精密ホットメルトディスペンサで実現！ ノードン様 | | 液晶ポリマー (LCP) 材料と繊維製品、電子部品への応用 | | 寧波聚高新材料科技 (JUJIA) |
| 11:35-11:55 | 表面改質の最新技術をご紹介！ (コーティング不要の撥液処理による液滴精度の向上、ガス不要の還元処理) 株式会社半導体 | | 新商品フレキシブル基板 (FPC) | | 沖電線様 |
| 12:15-12:35 | | | あらゆる計測器を同時監視！ソフトウェア開発歴26年の実績で挑む、IoT技術の新たな付加価値。 株式会社エージェンシー | | 伊藤電機株式会社 |
| 13:35-13:55 | | | エッジコンピューティングとクラウドの融合 Izuma Networks | | |
| 14:15-14:35 | | | 高誘電率BT樹脂積層材料の紹介 三菱ガス化学様 | | |
| 14:55-15:15 | | | 自由自在な多段階配置で大小部品混載一括実装を実現するマルチステップマスク レーザーシステムズの特長と性能～ 株式会社ブルックスジャパン | | |
| 10:55-11:15 | ウソコ電機の露光装置とエキシマ照射装置 | | IHリフローで実現する新しいものづくり 低耐熱・高放熱基板上での部品実装を量産まで対応 超低消費電力で、製造工程でのCO ₂ 削減、SDGsに貢献 株式会社ウソコ電機 | | 株式会社ブルックスジャパン |
| 11:35-11:55 | 基板及び電子部品加工向けレーザ加工機のご紹介 澁谷工業様 | | フレキシブル基板+ワイヤハーネス パワーデバイス材料の絶縁性能評価技術のご紹介 株式会社ニックス | | 麗裕企業様 |
| 12:15-12:35 | | | IoTデバイスの電源問題を解決！自立型IoTの社会実装を EnerCera で実現 日本ガイシ様 | | |
| 12:55-13:15 | CAD/CAMデータを活用したデータダイレクトソリューション ダイナトロン様 | | IoTデバイスの電源問題を解決！自立型IoTの社会実装を EnerCera で実現 日本ガイシ様 | | |
| 13:35-13:55 | 新フィルム状塗布システムの誕生 プリント基板露光技術について 株式会社テクノロジ | | FC-BGA 向け次世代BT樹脂積層材料の紹介 マッチ箱サイズの超コンパクトレーザー、MatchBoxシリーズの最新の動向とアプリケーション事例についてご紹介いたします。 フォトテックニカ様 | | 三菱ガス化学様 |
| 14:15-14:35 | BGA実装基板検査の課題を解決するJTAG/(バウンダリスキャン)テストのご紹介 アンドールシステムサポート様 | | プリント基板製造工程用研磨ホイール新商品のご紹介 「SR前パフカス詰まり対応研磨ホイール」 「穴埋めインク除去用研磨ホイール」 金井重要工業様 | | |
| 14:55-15:15 | インクジェット塗布技術紹介 株式会社井表記 | | 基板にダメージを与えず微小物を確実に除去するために～Teknekのクレーニングの化学～ 株式会社ブルックスジャパン | | |
| 15:35-15:55 | | | DXと新しいデジタルマーケティングの創出 株式会社東亜無線電機 | | |
| 16:15-16:35 | | | 基板分割はレーザーカットの時代へ LPKFレーザーダイナミクス (基板分割) 最新情報をお届け LPKF Laser & Electronics様 | | |
| 10:15-10:35 | パワー半導体向け3Dプレス技術とシンタリング (焼結) 装置開発のご紹介 日機装機 | | ファナックロボットの最新技術 ファナック様 | | |
| 10:55-11:15 | 素材の特性を見える化する！エレクトロニクス材料の熱分析と粘弾性測定 ティール・エイ・インストルメント・ジャパン様 | | 電子回路基板用ドリル、ルーターの最新技術情報 ユニオンツール様 | | |
| 11:35-11:55 | | | 電子回路基板用ドリル、ルーターの最新技術情報 ユニオンツール様 | | |
| 12:15-12:35 | | | 電子回路基板用ドリル、ルーターの最新技術情報 ユニオンツール様 | | |
| 12:55-13:15 | 電子部品・半導体製造工程でのDLC (ダイヤモンド・ライク・カーボン) コーティング活用事例。5G通信帯域で使用可能な低誘電率DLCなど、各種機能性DLCの紹介。 株式会社プラズマイオンアシスト | | 大口ロジック / 高速伝送用途 / 次世代FOWLPおよびFOPLP向け 奥野製薬工業の半導体パッケージ基板用 硫酸銅めっき添加剤 奥野製薬工業様 | | |
| 13:35-13:55 | カーボンニュートラル、低応力接合に対応可能な各種低温硬化型接着材料およびはんだペーストの紹介 日邦産業様 | | 大口ロジック / 高速伝送用途 / 次世代FOWLPおよびFOPLP向け 奥野製薬工業の半導体パッケージ基板用 硫酸銅めっき添加剤 奥野製薬工業様 | | |
| 14:15-14:35 | プリント基板設計 AI 自動配置ソリューションのご紹介 株式会社オンテック | | LTSpiceをPCB設計に活用する。 (SW電源部のトレースやVIAのインダクタンス成分に注目して) 株式会社三共 | | |
| 14:55-15:15 | | | | | |

OITDAセミナー「産業の高度化・微細化に貢献する光・レーザ技術」 **無料** **要事前登録** 会議棟1階 102会議室

| 5月31日 (水) | |
|-------------|--|
| 10:25-10:30 | 主催者挨拶 小谷 泰久 (一財)光産業技術振興協会 副理事長兼専務理事 |
| 10:30-11:15 | レーザ加工のリアルタイム監視 (仮) 小林 洋平 東京大学 物性研究所 附属極端レーザー光科学研究所 センター 教授 |
| 11:15-12:00 | プリント基板加工の現状と将来 (仮) 金田 充弘 三菱電機様 |
| 13:00-13:45 | スマートグラス関連 (仮) 高木 裕行 セイコーエプソン様 |
| 13:45-14:30 | マイクロ・ナノフォトニクス欧州エコシステムの可能性を探る (仮) カルロス・リー European Photonics Industry Consortium (EPIC) Director General |
| 14:30-15:15 | Trends and Opportunities in the Photonics Industry ホセ・ボソ OPTICA (USA) |

interOpto/Imaging Japan 次世代通信に向けた光電融合技術セミナー **無料** **要事前登録** セミナー会場 J

| 6月1日 (木) | |
|-------------|--|
| 13:00-13:50 | Society5.0時代の大容量情報通信を支える光・電波融合デバイス・システム基礎技術 山本 直寛 (国研) 情報通信研究機構 ネットワーク研究所 フォトニックICT研究センター・副センター長 / 先端ICTデバイスラボ・ラボ長 (兼任) |
| 13:50-14:30 | 光電融合を支えるハイブリッド光デバイスの開発 岡本 浩行 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 情報コース 教授 |
| 14:30-15:10 | 集積光コム光源 (マイクロコム) と通信への応用 久世 直也 徳島大学ポストLEDフォトニクス研究所 次世代光研究部門 准教授 |
| 15:10-15:40 | フォトニックサイエンステクノロジー製のファイバー製造技術とファイバ (部品) 開発技術 小林 社一 フォトニックサイエンステクノロジー様 代表取締役社長 |

テラヘルツテクノロジーフォーラム 第15回テラヘルツビジネスセミナー (THz.biz 2023) ~テラヘルツセンシングの応用展開~ **無料** **要事前登録** セミナー会場 J ※展示会場 (要事前登録) + Zoom 配信 (ハイブリッド開催)

| 5月31日 (水) | |
|-------------|---|
| 13:00-13:05 | 開会あいさつ/プログラム案内 林 伸一郎 テラテックフォーラム (情報通信研究機構) 戦略企画委員長 |
| 13:05-13:35 | THz (300GHz) 対応 Beyond5G/6G 向けアンテナ計測と空間電波可視化技術 杉山 武史 株式会社フォトニクスエッジ 代表取締役 |
| 13:35-13:55 | 講演タイトル調整中 碓 智文 株式会社スペクトルデザイン 部長 |
| 13:55-14:25 | 講演タイトル調整中 芹田 和剛 大阪大学 経営企画オフィス 准教授 |
| 14:25-14:45 | Beyond 5G に向けた材料・デバイスの周波数特性計測システムのご紹介 加藤 英志 株式会社バドテスト 新事業推進室 TAspjマネージャー |
| 14:45-15:15 | 講演タイトル調整中 門内 靖明 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 准教授 |
| 15:15-15:35 | 300GHzフォックスルーポディーズキャッチャーの開発 大谷 知行 (国研) 理化学研究所 チームリーダー |
| 15:35-15:50 | まとめ+NICFフレームワーク 齋藤 伸吾 (国研) 情報通信研究機構 (テラテックフォーラム) 主任研究員 |

interOpto/Imaging Japan 企業プレゼンテーション **無料** **事前登録不要** セミナー会場 J

| 5月31日 (水) | |
|-------------|---|
| 11:30-11:50 | 高性能スキャニングオートコリレータ pulseCheckシリーズ紹介： 独国 APE 社製 フォトテックニカ様 |
| 12:05-12:25 | 銅炭素複合材料による次世代ソフトエレクトロニクスデバイスの 放熱設計への展開 UBE様 |

| 6月1日 (木) | |
|-------------|--|
| 10:30-11:00 | 同時多波長測定を可能にするポリクロメータ式 光スベアナのご紹介 株式会社島津製作所 |

出展者一覧

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|
| <p>スポンサー企業</p> <p>プラチナ アドテックエンジニアリング イ・エス・アイ・ジャパン メコー</p> <p>ゴールド アドテックジャパン イ・エス・アイ・ジャパン FICT ダイナトロン 太陽インキ製造 マダニキ/イ・エス・アイ・ジャパン・ソリューションズ・ジャパン メック</p> <p>シルバー 京亨 松和産業</p> <p>ブロンズ 金井重要工業 JPCAめっき委員会 東亜無線電機 ニッコン工業</p> <p>JPCA Show プリント基板技術展</p> <p>IMV IDAJ アイエ 鉅峰企業 actinano アスマ アドテックエンジニアリング アドテックジャパン アルメックステクノロジー イ・エス・アイ・ジャパン 石井表記 石原ケミカル いずみ製作所 出雲市 利送イーエムシー イチカワテクノファブリス 伊原電子工業 イワキ インスペク インタ・エクスソフト WECC (世界電子回路業界団体協議会) ウソコ電機 HAA光学 HKPCA (香港線路板協会) エイト工業 エーティージー ルーサー アンド メルツァー FICT LPKF Laser & Electronics オーク製作所 オツカ光学 大船企業日本 オカダジーエーエイ オンテック 鹿児島県 華正新材料 金井重要工業</p> | <p>カネカ 広東駿亞電子科技 北川精機 協栄プリント技研 京亨 清川メッキ工業 熊本県 クラボウ KFE Hong Kong KPCA (韓国電子回路産業協会) ケムテックス ケムトロン 合成樹脂工業協会 神戸大学工学研究科 電気電子工学専攻 塚本・寺田研究室 Goal Searchers, ZHUHAI Korea Packaging Integration Association (KPIA) コムスキャンテクノ 相模ピーシーアイ 魁半導体 山本化学 三菱技研工業 CPCA (中国電子回路産業協会) ジェテックイーエム J-RAS JCU SHENGYI TECHNOLOGY 四会富仕電子科技 國産化成工業 澁谷工業 樟葉町 橋本電子通 JADASON Enterprises ジャブ工業 JIANGXI JIANGNAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS Schmoll Maschinen 松和産業 ショーダテクトロン シライ電子工業 伸光製作所 新興電気 深圳市ニューセス企業 SHENZHEN JINZHOU PRECISION TECHNOLOGY Shenzhen Jinxin Electronic Technology Shenzhen Mason Electronics SCREEN PEソリューションズ ステラ ステラ・コーポレーション 大成ラミネーター ダイヤセル ダイナトロン 大日光・エンジニアリング 太陽インキ製造 太洋工業 ダイヤ ダイヤ工業 タカノ タケウチ China Circuit Technology (Shantou) チュウリッパ 角田フロン製作所 ティーンズティー・ジャパン TPCA (台湾回路板協会) TESTONIC テスプロ TAESUNG</p> | <p>デノロ・ベルメック デンカ 電子回路企業年會基金 電子情報技術産業協会 (WEITA) 電波新聞社 東京マシナ・アンド・ツール 中島化学産業 ニコル / ニコンソリューションズ ニッコン工業 日興運送 ニッコー・マテリアルズ 日東紡績 内藤電機工業 日放電子 カルノウーター ニテックアパレルテクノロジー (旧-日本電産リード) 日本アプリアマテリアルズ 日本エレクトロ・チャールズ 日本電子回路工業会 (JPCA) 日本ビューテックス 日本ミクロン ハイテック 仙東 PAN-TEC ピアンカフス GIGAVIS PCBGOGO 日立ハイテクサイエンス フォーネス 和仁貿易 フィッシャー・インストルメント イ・テクノロジ 福田金属箔工業 富士高分子工業 フジブリグループ 藤森工業 ブルックスジャパン ヘアック マイクロラフト マコー マツダエイト 丸源機工所 ミカテクノス ミロ技術研究所 三菱ガス化学 メイコ MeiLink メック メルテックス モノロニクス エスベック 山形大学 YU-FIC ヤマハフラインテック ユニオンツール JNC RYODEN (旧: 東電商事) 新菱 テラスホールディングス ティール・エイ・インストルメント・ジャパン TEGソリューション 電気印刷研究所 東芝ビジネスエキスパート 日邦産業 日本スベリア社 ノーソン ハニ化成</p> | <p>半導体パッケージング・部品内蔵技術展</p> <p>アズワン ADEKA AJ エクシール 奥野製薬工業 カルツァイス 三喜製作所 JSR 世紀精密 トワテック 内藤電機工業 長瀬産業 日本電気硝子 日本バーンズ 九州大学 フジエイト クリンケム 群馬大学大学院 理工学府 公立諏訪東京理科大学 機械電気工学科 公立諏訪東京理科大学 地域連携開発機構 山陽小野田市立山口東京理科大学 シチメンファインデバイス 信州大学 工学部 電子情報システム工学科 先端磁気デバイス (佐藤・曾根原) 研究室 信州大学スピンドルデバイステクノロジーセンター</p> <p>フレキシブルプリント記録板製品 出展エリア</p> <p>ISC 麗裕企業 沖電線 GIGAVIS Korea Electronics Technology Institute シーマ電子 寧波聚高新材料科技 (JUJIA) 東海大学 東京工業大学 明和産業 山下マテリアル ワンダーフューチャーコーポレーション 機器・半導体受託生産システム展 ODTECH 富士工業 ヘアック Luci 和光電研</p> <p>マイクロエレクトロニクスショー</p> <p>Addison Clear Wave Coating EME エレクトロニクス実装学会 (JIEP) 日機装 eX-tech 秋田化学工業 アテネ アドバンスマテリアルテクノロジー アンドールシステムサポート エスベック 大阪有機化学工業 クワザフ JNC JNC 石油化学 Shimada Applii 新菱 テラスホールディングス ティール・エイ・インストルメント・ジャパン TEGソリューション 電気印刷研究所 東芝ビジネスエキスパート 日邦産業 日本スベリア社 ノーソン ハニ化成</p> | <p>ピーエムティー 日立ソリューションズ 藤倉化成 フラスマイオンアシスト メルコセミコンダクタエンジニアリング</p> <p>アカデミックプラザ</p> <p>岩手大学 エクストコム 愛媛大学 大阪公立大学 沖エンジニアリング 神奈川県立産業技術総合研究所 カルノウーター 関東学院大学大学院工学研究科 九州大学 クリンケム 群馬大学大学院 理工学府 公立諏訪東京理科大学 機械電気工学科 公立諏訪東京理科大学 地域連携開発機構 山陽小野田市立山口東京理科大学 シチメンファインデバイス 信州大学 工学部 電子情報システム工学科 先端磁気デバイス (佐藤・曾根原) 研究室 信州大学スピンドルデバイステクノロジーセンター</p> <p>SDGsデバイス展</p> <p>アンピス 産業タイムズ社</p> <p>WIRE Japan Show</p> <p>工業通信</p> <p>Electronics Component & Unit Show</p> <p>アルル電子 飯田通商 NNP 岡本無線電機 グローバルディスプレイ コアスタ 三共社 成電社 成電社 奥田貿易 奥田電気 オムロン 化研テック 川崎重工業 サヤカ CKD JFE商事エレクトロニクス JKUI ジュツジジャパン 設立電気工業 太平洋電機産業 タムラ製作所 テックアルファ 東京大学 東洋物産 日本マン</p> | <p>日本スベリア社 日本ミルテック 日本ロボット工業会 (JARA) パルミジャン ハイウエイ バスコン 白光 パナソニック コネクト ファナック FUJI ブルックス・ジャパン プロセス・ラボ・ミクロン ペラーインダストリーズ・インク ベントロン ボジンジャパン マルコム 武蔵エンジニアリング ヤマハ発動機 ルックス電子</p> <p>Smart Sensing 無人化ソリューション展 Edge Computing</p> <p>interOpto Imaging Japan</p> <p>JISSO PROTEC</p> | <p>INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS SOCIETY interOpto</p> <p>アイ・アール・システム アイオーコア アドコム・メディア アドバニシティ アルネアラボラトリ イー・アンド・イーエソリューション the international society for optics and photonics (SPIE) エム オプトニクス社 オンレンジアチ 韓国光産業振興会 京都光技術研究会 SMK エネルギーハーベスティングコンソーシアム グロブ 湖北工業 ジュニアアラト ジェー・イー・ウーラム・ジャパン 芝罘工業 島津製作所 Stella スペーステクノロジー コネクテッドジャパン 産業技術総合研究所 ジャパンディスプレイ 住友金属鉱山 技術本部 技術企画部 センリオン ソフエージェンシー 泰興物産 ダイオームウェア タッチエクス 樟本興業 デザインインターナショナル デルタレーシング 東海理化電機製作所 東京電子工業 東大北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室 内藤電機可田製作所 ナシード ナルコム 日伝 日本ガイシ 福田基研研究所 富士通コンポーネント フジク ボムウェア ポリテックジャパン ポルトラン マイクロモジュールテクノロジー マルセル マルティス ミオ・コーポレーション MODE, Inc. ものづくりメカニクス ヤマ電気 横山商会 ロボティクス普及促進センター</p> <p>Imaging Japan</p> <p>イ・エス・テクノロジ エバ・ジャパン サイバネットシステム 太平貿易 日通機械 三ツ波</p> |
|--|---|---|--|---|---|---|

Keynote Speech

| 5月31日 (水) | |
|-------------|--|
| 14:40-15:30 | 世界のトレンドからみたメーカーのトレンドとトコへの転換 上野 聡志 MODE, Inc. VP of Business |

| 6月1日 (木) | |
|-------------|---|
| 10:15-11:05 | スマートセンシングとインターパス 持丸 正明 (国研) 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長 |
| 11:35-12:25 | <ビッチステージ> 社会実装に進む磁歪振動発電機の製品開発と将来展望 未定 |

| 6月2日 (金) | |
|-------------|---|
| 11:35-12:00 | 構内物流の自動化で実現するオペレーションの効率改善 三村 健二 株式会社イノベーション戦略事業本部 スマートシティ&モビリティ事業部 課長 |
| 12:00-12:25 | ライブデモで実演!! ヒト・モノの移動における無人化を見据えて ~モビリティデータ活用を取り組み~ 上原 拓 株式会社イノベーション戦略事業本部 スマートシティ&モビリティ事業部 |

interOpto/Imaging Japan 計測・分析・解析技術セミナー **無料** **要事前登録** セミナー会場 J

| 6月1日 (木) | |
|-------------|---|
| 11:15-11:45 | 講演タイトル調整中 サイバネットシステム様 |
| 11:45-12:15 | 3D外観検査のためのレーザ構造化照明を実現するDOE技術 川島 勇人 株式会社ベースフォトン 代表取締役 |

interOpto/Imaging Japan スマートライフ向け 光デバイス最新動向セミナー **無料** **要事前登録** セミナー会場 J

| 6月2日 (金) | |
|-------------|---|
| 10:30-11:10 | ドローンを活用した農林水産業のスマート化 吉本 直人 公立千歳科学技術大学 理工学部電子工学科 教授 |
| 11:10-11:40 | "Improving Life with Photons" ("光" で生活を豊かにする) (仮) Luminus Devices社 / 丸文様 |
| 11:40-12:10 | タイトル調整中 鈴木 敦志 E&E evolution様 代表取締役 |

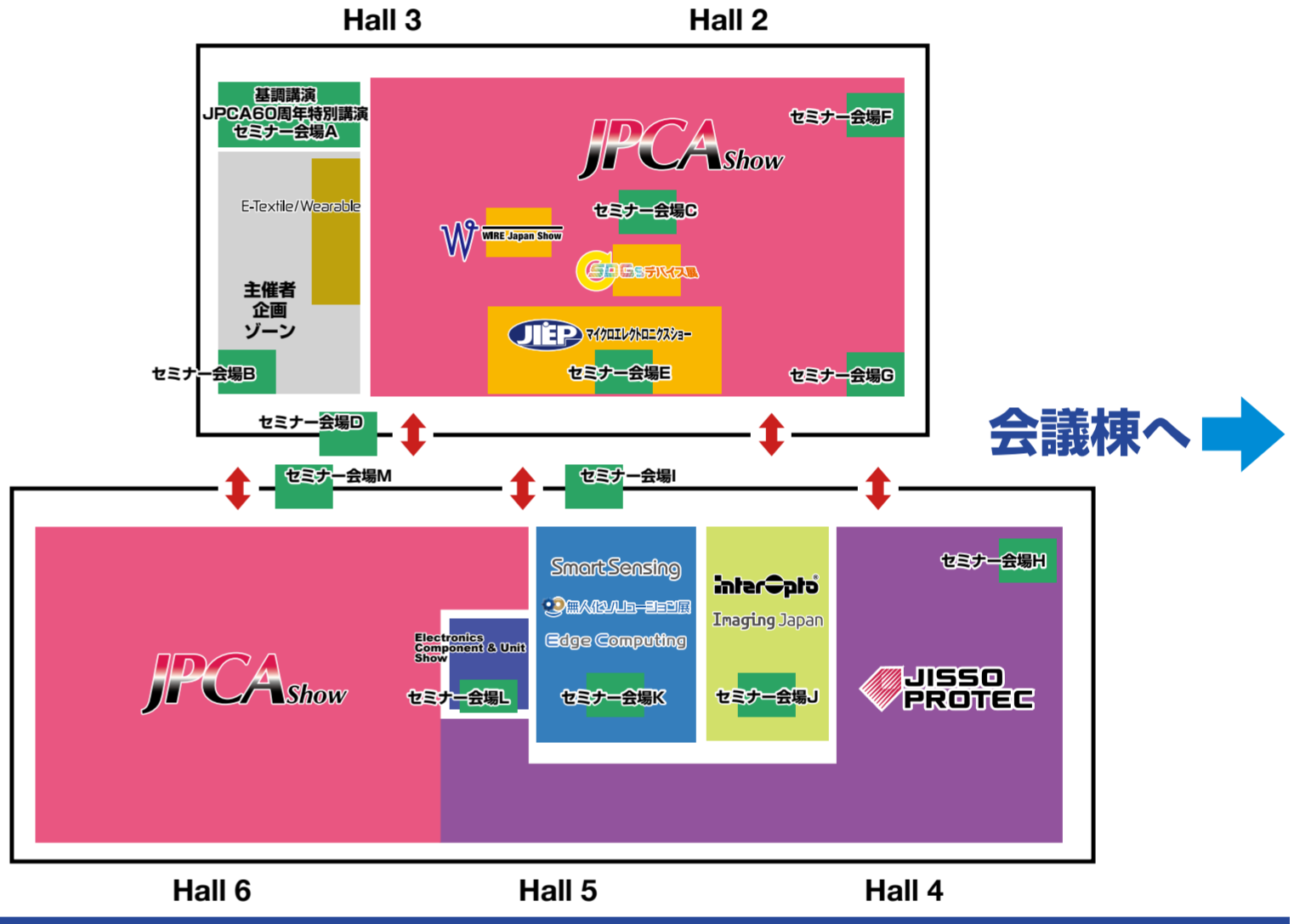
interOpto/Imaging Japan スマートファクトリー向けカメラ・センサー・システム最新技術セミナー **無料** **要事前登録** セミナー会場 J

6月2日 (金) 13:00-14:30 講演タイトル・講演者は調整中

注目される光技術セミナー **無料** **事前登録不要** セミナー会場 J

5月31日 (水) ~ 6月2日 (金) 講演時間・タイトル・講演者は調整中

展示ホール内ゾーニング



会議棟へ

2023年3月22日 (水) 現在 (展示会別・50音順)